

# 半导体

## 全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长

我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。

回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

SEMICON China 于 2021 年 3 月 17 日至 19 日在上海新国际博览中心举办。在论坛与参展企业上，关于中国半导体设备材料发展情况的会后总结。

**全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长。**2020 年整体市场逐渐回复，预计同比会有 7% 以上的增长，达到 4398 亿美元；2021 年景气将会持续优于 2020 年，预计同比达到 12%，达到 4929 亿美元。中国芯片自给率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控成为发展核心。自主可控成为国家发展半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制造的设备材料是发展产业链自主可控的重要方向。根据 SEMI 的预测，**2021 年全球半导体设备市场 719 亿美元**，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间，2021 年中国大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备市场比例的 23%；目前国内半导体设备处于 0 到 1 的突破阶段，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。根据 SEMI 的预测，**2021 年全球半导体材料市场 565 亿美元**，中国产能占比仍有很大的提升空间。随着中国半导体产业的发展，2021 年中国半导体材料市场规模预计达到 104 亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅 13% 到 15%，仍有很大的提升空间。

**国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破。**(1) 中微公司：展出最新双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备，目前已收到来自国内领先客户的订单，首台设备已交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产的良率稳定。(2) 北方华创：8 寸、12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案，应用领域覆盖集成电路 IC、功率器件、先进封装、微机电系统、半导体照明等。(3) 盛美半导体：展出 Ultra C 清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备，大幅度提高生产效率，达到低耗材成本 COC 和运行成本 COO 的优势。(4) 华海清科：展出 Universal-300T 化学机械抛光设备，满足 28nm 以下逻辑工厂以及 1xnm 存储工厂等各种工艺需求。

**国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向。**(1) 沪硅产业：全球化布局，形成中欧两地的跨国企业。其中子公司上海新昇通过自主研发，解决国内 300mm 半导体硅片依赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产。(2) 中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶硅、硅抛光片，12 英寸硅片 2020 年开始投产。

我们建议关注主要海内外半导体产业链上的设计、制造企业。建议关注：ASM Pacific/长川科技/北方华创/雅克科技/华懋科技/晶瑞股份/洁美科技/卓胜微/思瑞浦/新洁能/中芯国际(港)/华虹半导体(港)

风险提示：疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期

证券研究报告

2021 年 03 月 21 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070005  
panjian@tfzq.com

陈俊杰

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517070009  
chenjunjie@tfzq.com

行业走势图



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《半导体-行业深度研究:半导体检测设备:从前道到后道,全程保驾护航》2021-03-16
- 2 《半导体-行业研究周报:中美合作在半导体国产化与上升周期中朝向正向发展》2021-03-14
- 3 《半导体-行业研究周报:海外半导体业绩超预期 行业龙头指引景气》2021-02-01

## 主要观点

我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。

回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

SEMICON China 于 2021 年 3 月 17 日至 19 日在上海新国际博览中心举办。在论坛与参展企业上，关于中国半导体设备材料发展情况的会后总结。

**全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长。**2020 年整体市场逐渐回复，预计同比会有 7% 以上的增长，达到 4398 亿美元；2021 年景气将会持续优于 2020 年，预计同比达到 12%，达到 4929 亿美元。中国芯片自给率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控成为发展核心。自主可控成为国家发展半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制造的设备 and 材料是发展产业链自主可控的重要方向。根据 SEMI 的预测，**2021 年全球半导体设备市场 719 亿美元**，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间，2021 年中国大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备市场比例的 23%；目前国内半导体设备处于 0 到 1 的突破阶段，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。根据 SEMI 的预测，**2021 年全球半导体材料市场 565 亿美元**，中国产能占比仍有很大的提升空间。随着中国半导体产业的发展，2021 年中国半导体材料市场规模预计达到 104 亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅 13% 到 15%，仍有很大的提升空间。

**国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破。**(1) 中微公司：展出最新双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备，目前已收到来自国内领先客户的订单，首台设备已交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产的良率稳定。(2) 北方华创：8 寸、12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案，应用领域覆盖集成电路 IC、功率器件、先进封装、微机电系统、半导体照明等。(3) 盛美半导体：展出 Ultra C 清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备，大幅度提高生产效率，达到低耗材成本 COC 和运行成本 COO 的优势。(4) 华海清科：展出 Universal-300T 化学机械抛光设备，满足 28nm 以下逻辑工厂以及 1xnm 存储工厂等各种工艺需求。

**国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向。**(1) 沪硅产业：全球化布局，形成中欧两地的跨国企业。其中子公司上海新昇通过自主研发，解决国内 300mm 半导体硅片依赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产。(2) 中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶硅、硅抛光片，12 英寸硅片 2020 年开始投产。

我们建议关注主要海内外半导体产业链上的设计、制造企业。建议关注：ASM Pacific/长川科技/北方华创/雅克科技/华懋科技/晶瑞股份/洁美科技/卓胜微/思瑞浦/新洁能/中芯国际(港)/华虹半导体(港)

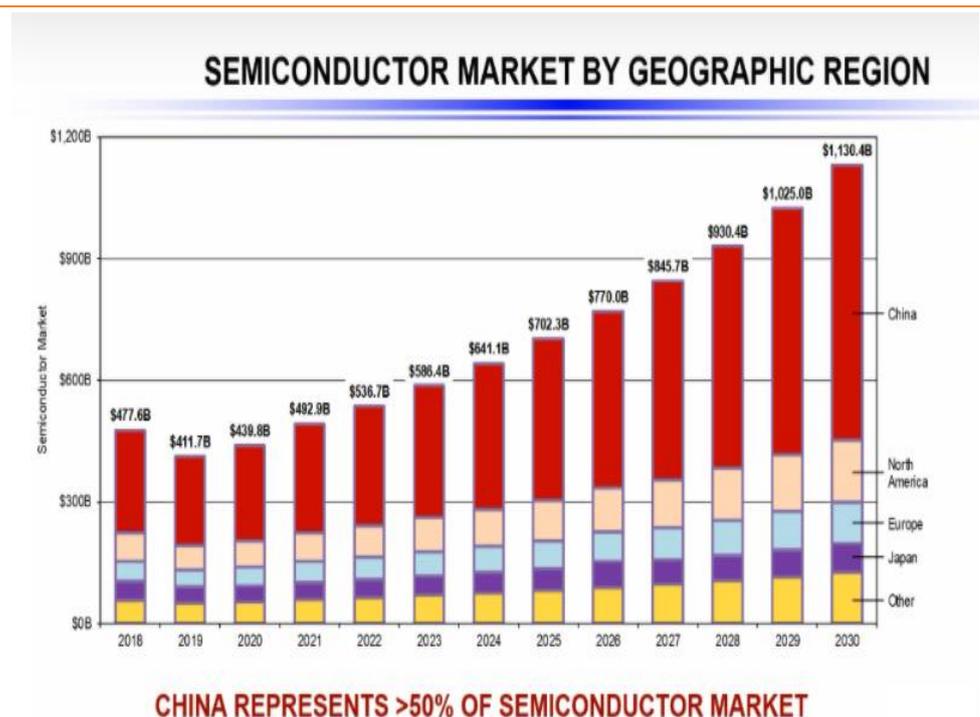
## 1. 全球半导体产业联动上游设备材料，启动新一轮增长

**全球半导体市场 2021 年有望达到 4929 亿美元，同比提升 12%。**2020 由于 5G/AI/IOT 的普及、汽车行业景气复苏、疫情带来的居家办公需求等下游应用持续向好，带动半导体需求持续提升，预计整体景气将会持续到 2021 年。回顾过去 3 年，根据 Semi 发布的数据，2018 年全球半导体市场规模达到 4776 亿美元是过去十年来的高点；2019 年由于内存市场供需市场以及终端设备市场需求疲软，导致整体半导体市场规模下滑至 4117 亿美元；2020 年整体市场逐渐回复，预计同比会有 7% 以上的增长，达到 4398 亿美元；2021 年景气将会持续优于 2020 年，预计同比达到 12%，达 4929 亿美元。

**中国作为半导体需求大国，需求增长将会持续。**回顾半导体产业历史，历经 2 次产业转移，从美国到日本再到韩国及中国台湾；现在处于第三次转移，全球半导体行业的重心将会往中国大陆。随着半导体技术以及下游应用的不断发展和进步，中国已经成为全球半导体消费大国，在全球半导体市场中占比超过 50%。中国市场的快速增长，是全球集成电路发展的主要动力之一。

**中国芯片自给率低仍有很大的缺口，半导体产业链自主可控成为发展核心。**2019 年国内芯片自给率仅有 30% 左右，尤其受到中美贸易战的影响，自主可控成为国家发展半导体产业的重中之重，其中发展国内的半导体制造的设备 and 材料是发展产业链自主可控的重要方向。

图 1：全球半导体市场规模



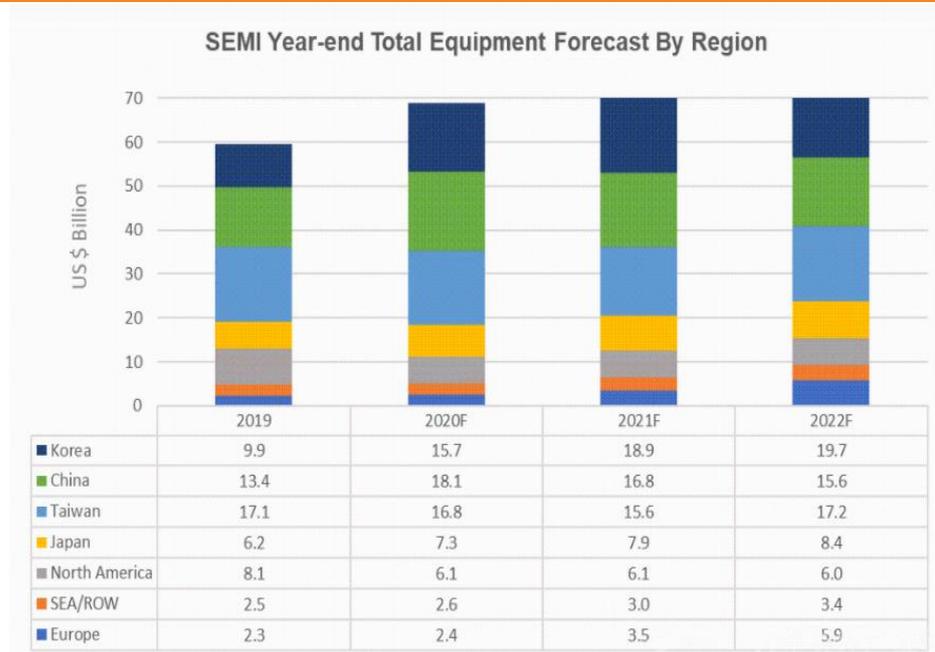
资料来源：SEMI，天风证券研究所

**下游旺盛需求将会传导至上游，半导体设备材料市场规模将会持续增长。**半导体下游需求旺盛，导致晶圆出现严重紧缺，预计需求将会持续发烧；因应旺盛的需求，制造商提高 2021 年资本支出，我们以全球代工龙头台积电为例，2021 年资本支出目标创历史新高，达到 250 亿至 280 亿美元；资本支出目标的提升将会带动设备材料的需求。

**全球半导体设备市场 719 亿美元，中国占比高为国内设备企业带来较大的发展空间。**根据 SEMI 的预测，预计 2020 全球半导体设备市场规模将会达到 689 亿美元，相较于 2019 年的 596 亿美元，同比增长 16%，预计全球半导体制造设备市场将继续增长，2021 年预计突破 700 亿美元，达到 719 亿美元。随着国内晶圆代工工厂以及存储投资的

推动下，2021 年中国大陆半导体设备市场规模将会达到 168 亿，占全球半导体设备市场比例的 23%。但全球半导体设备厂商排名，前十名几乎被海外企业垄断；目前国内半导体设备处于 0 到 1 的突破阶段，国内企业包含中微公司、北方华创、盛美半导体、华海清科等，在各个节点都有所进展，但整体还有非常大的提升空间。

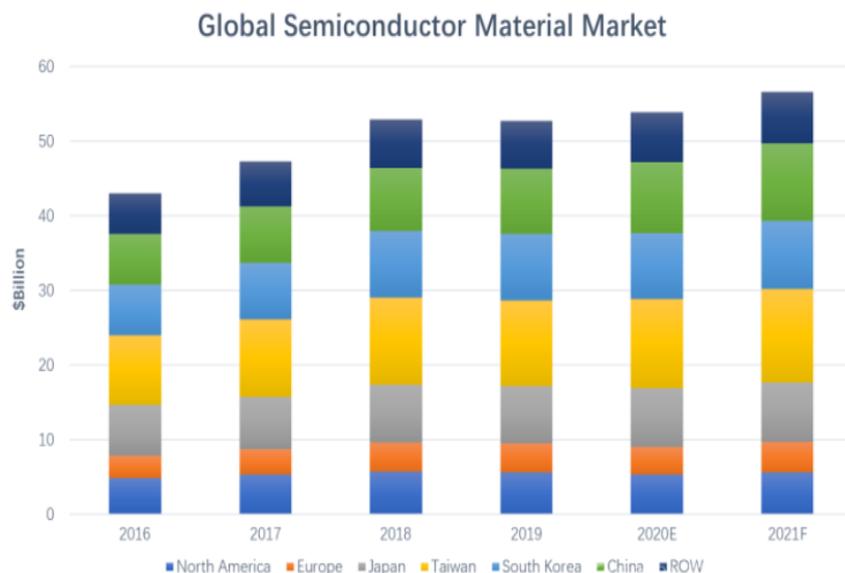
图 2：全球半导体设备市场规模以及按照地区拆分的市场规模



资料来源：SEMI，天风证券研究所

**全球半导体材料市场 565 亿美元，中国产能占比仍有很大的提升空间。**半导体材料是半导体产业发展的基础，包含主要有硅片、光掩膜、光刻胶、溅射靶、抛光液等。根据 SEMI 预计，2020 年全球半导体材料市场达 539 亿美元，同比增长 2.2%，其中中国大陆市场增速高于全球市场增速，达到 9.2%，也是全球唯二增长的市场；2021 年将会保持增长，预计 2021 年将会达到 565 亿美元，总体市场规模会再次创历史新高。随着中国半导体产业的发展，2021 年中国大陆半导体材料市场规模预计达到 104 亿美元，成为全球第二大半导体材料市场；但是全球半导体材料被日本企业占据，中国占全球产能的 13%到 15%，仍有很大的提升空间。

图 3：全球半导体材料市场规模以及按照地区拆分的市场规模



资料来源：SEMI，天风证券研究所

## 2. 国内半导体设备公司：新设备新工艺，实现 0 到 1 到 N 突破

### 中微公司：Semicon China 展出最新双反应台 ICP Primo Twin-Star 设备

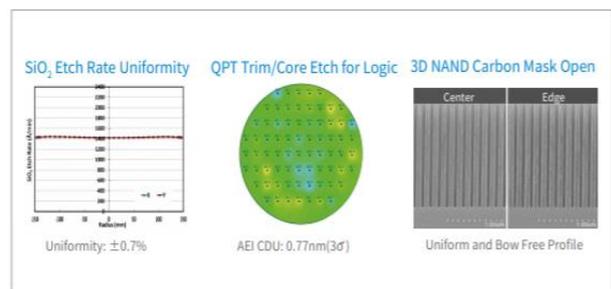
Primo Twin-Star 是基于电感耦合等离子体（ICP）技术并使用双反应腔体的 12 寸刻蚀设备，主要应用于 1X nm 及以下的逻辑和存储刻蚀。设备可外挂 3 个 chamber，最多可以配置到 6 个刻蚀反应腔。凭借创新的反应腔设计，产品拥有以下特点：（1）通过采用多区温控静电吸盘（ESC）可以使关键尺寸达到高度均匀性；（2）发射天线采用低电容耦合 3D 线圈，各 chamber 可以实现离子浓度和能量的高独立控制；（3）反应腔内部图有高致密性、耐等离子体侵蚀的材料，可以达到更好的工艺重复性和生产效率；（4）延续双反应台高效率、低成本的特性，相较于其他同类设备相比，拥有更小的占地面积、更低的生产成本、更高的输出效率等优势。目前公司该刻蚀设备已收到来自国内领先客户的订单，首台设备已交付客户投入生产，由于产品拥有很好的刻蚀均匀性及高深宽比刻蚀性能，投入生产的良率稳定。

图 4：中微公司 ICP Primo Twin-Star 设备



资料来源：中微公司官网，天风证券研究所

图 5：中微公司 ICP Primo Twin-Star 设备相关参数



资料来源：中微公司官网，天风证券研究所

中微公司参股的沉积设备公司沈阳拓荆，展示 3D NAND PECVD 及 12 英寸 PECVD 设备。拓荆科技股份有限公司成立于 2010 年 4 月，公司拥有自主知识产权并包含 12 英寸 PECVD（等离子体化学气相沉积设备）、ALD（原子层薄膜沉积设备）、3D NAND PECVD（三维结构闪存专用 PECVD 设备）三个完整系列产品，应用领域覆盖集成电路前道和后道、TSV 封装、光波导、LED、3D-NAND 闪存、OLED 显示等高端技术领域。

图 6：12 英寸 3D-NAND PECVD 设备



资料来源：沈阳拓荆官网，天风证券研究所

## 北方华创：8 寸、12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案

北方华创 8 寸集成电路领域设备及工艺解决方案包含，硅刻蚀机、金属刻蚀机、通用物理气相沉积系统、单片常压硅外延系统、立式低温退火系统、全自动槽式清洗机等。12 寸集成电路领域设备及工艺解决方案包含加热型原子沉积系统、单片退火系统、立式氧化系统、立式低压化学气相沉积系统、立式低温退火系统等；应用领域覆盖集成电路 IC、功率器件、先进封装、微机电系统、半导体照明等。

图 7：北方华创设备系列

### 产品系列

- 等离子刻蚀设备 Etcher
- 物理气相沉积设备 PVD
- 化学气相沉积设备 CVD
- 氧化扩散设备 Oxide/Diff
- 清洗设备 Cleaning Tool
- 紫外固化设备 UV Cure
- 移载传送设备 Indexer
- 辅助设备 Facility
- 气体测量控制 Gas Measuring Control
- 备品备件 Parts
- 原子层沉积设备 ALD
- 客户服务 Services

资料来源：北方华创官网，天风证券研究所

## 盛美半导体：Semicon China 展出 Ultra C 清洗设备以及 Ultra ECP Map 电镀设备

1) SAPS 兆声波清洗设备：应用领域包含深沟道清洗、CMP 后清洗、Hard Mask 沉积后清洗、Contact/Via 刻蚀后清洗、Barrier Metal 沉积前清洗、晶圆回收清洗、EPI 沉积前清洗以及 ALD 沉积前清洗。Ultra C SAPS V 延续 Ultra C SAPS II，可达到双面清洗，最多可配置 5 种清洗药液，包含 DHF SC1, SC2, DIO3, BOE, Solvent, HF/HNO3 等，最多配置 8 个腔体提升至 12 个腔体，产能也从 225WPH 提升至 375WPH，大幅度提高生产效率。

2) Ultra ECP Map 多阳极局部电镀设备：应用于 12 寸晶圆，55/40/28 和 28 纳米以下的大马士革铜金属层沉积。拥有脉冲局部电镀技术、适用于超薄种子层、高产能、独立模块设计等优势，可以达到 WIWNU < 1.5% 及 WTWNU < 1.5% 的电镀均一性。设备的配置上，最多可以配置 3 个 Load Port、最多可配至 4 个电镀腔体配备脉冲局部电镀功能、最多可配至 4 个清洗腔体、最多可配至 8 个退火腔体，达到低耗材成本 COC 和运行成本 COO 的优势。

图 8：盛美半导体 Ultra C 设备



资料来源：盛美半导体官网，天风证券研究所

图 9：盛美半导体 Ultra ECP map 设备



资料来源：盛美半导体官网，天风证券研究所

### 华海清科：Semicon China 展出 Universal-300T 化学机械抛光设备

华海清科成立于 2013 年，于 2019 年底，公司 CMP 设配稳定量产 12 寸晶圆突破 500 万篇，目前已经形成 Universal-300 X、Universal-300 Dual、Universal-300Plus、Universal-200Plus 等系列产品，实现化学机械抛光、研磨设备规格型号的全覆盖，并在国内外知名的集成电路生产线批量使用。Universal-300 于 2015 年批量进入大生产线，是国产首台 12 英寸 CMP 设备，满足 65~130nm Oxide/STI/Poly/Cu/W CMP 等各种工艺需求。Universal-300T 延续 300X 的基础上进行升级，可以满足 28nm 以下逻辑工厂以及 1xnm 存储工厂 Oxide/ SiN/STI/Poly/Cu/W CMP 等各种工艺需求。

图 10：华海清科 Universal-300X 设备



资料来源：华海清科官网，天风证券研究所

## 3. 国内半导体硅片公司：12 寸晶圆下一步重点方向

**沪硅产业：全球化布局，形成中欧两地的跨国企业。**

上海硅产业集团（沪硅产业）在上海有 2 家公司，收购芬兰的 Okmetic 并参股法国 Soitec，形成中欧两地的跨国企业。（1）上海新昇：通过自主研发创新解决国内 300mm 半导体硅片依赖进口的局面，目前已经形成比较大规模的生产；（2）上海新傲：国内领先的硅外延片供应商，可以提供 4 到 8 寸高质量的硅外延产品以及外延加工服务，产品应用于 SBD、VDMOS、IGBT、TVS 等分立器件以及 CMOS、Bipolar 等 IC；（3）Okmetic，于 1985 年生产硅片并于 2001 年生产 SOI 晶圆，2016 年公司收购后成为在欧洲重要的据点；（4）Soitec：公司作为并列第一大股东，能与上海新傲形成较好的战略联动。

图 11：硅产业集团全球布局



资料来源：沪硅产业官网，天风证券研究所

图 12：上海新昇制造工艺



资料来源：沪硅产业官网，天风证券研究所

### 中环股份：区熔单晶硅、直拉单晶硅、硅抛光片

中环股份 12 英寸硅片 2020 年开始投产。重/轻掺直拉硅单晶，可掺入特殊元素例如镓 (Ga)、锗 (Ge)，主要应用领域为各类集成电路、二极管、三极管、绿色能源太阳能电池等。重掺杂硅单晶，主要用作外延片的衬底材料，应用于制造超大规模集成电路开关电源、肖特基、二极管和场控高频电力电子器件等特殊电子器件，该工艺采用特殊掺杂装置及直拉工艺，可制备出电阻率极低的掺磷、砷、锑 (P、Sb、As) 的重掺直拉硅单晶。区熔工艺拉制的单晶硅片，拥有低杂质含量、低缺陷密度，晶格结构完整的特性，主要用于制作高压器件和光电子器件。

图 13：中环股份产品

	<p><b>直拉硅单晶硅片</b></p> <p>直拉硅单晶直拉硅单晶 (Cz-Silicon) 重/轻掺直拉硅单晶适用于制作各类集成电路、二极管、三极管、绿色能源太阳能电池等。可掺入特殊元素例如镓 (Ga)、锗 (Ge)，制作出特殊...</p> <p><a href="#">更多 &gt;</a></p>
	<p><b>抛光片</b></p> <p>抛光片FZ抛光片规格FZ polished wafers Specifications品种导电类型晶向直径范围 (mm)电阻率范围 (Ω.cm)几何参数、颗粒度及表面金属本征及超高阳区熔硅抛光片 (FZ)N...</p> <p><a href="#">更多 &gt;</a></p>
	<p><b>腐蚀片</b></p> <p>化腐片化腐片简介酸腐片以其较低的粗糙度，较好的光泽度，相对较低的成本，在一些领域逐渐开始直接使用酸腐片替代成本相对高抛光片或外延片制备电子器件，以降低成本...</p> <p><a href="#">更多 &gt;</a></p>
	<p><b>区熔硅单晶硅片</b></p> <p>区熔硅单晶本征及超高阳区熔硅单晶 (FZ-Silicon) 通过区熔工艺控制的低杂质含量、低缺陷密度，晶格结构完美的硅单晶，晶体生长过程中不引入任何杂质，其电阻率通常在10...</p> <p><a href="#">更多 &gt;</a></p>

资料来源：中环股份官网，天风证券研究所

## 4. 行情与个股

我们再次以全年的维度考量，强调行业基本面的边际变化，行业逻辑持续。半导体是景气度向上中持续受益板块，重点把握今年三大投资主线，坚定看好成长动能

我们认为，半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑，建议投资者持续把握三大投资主线

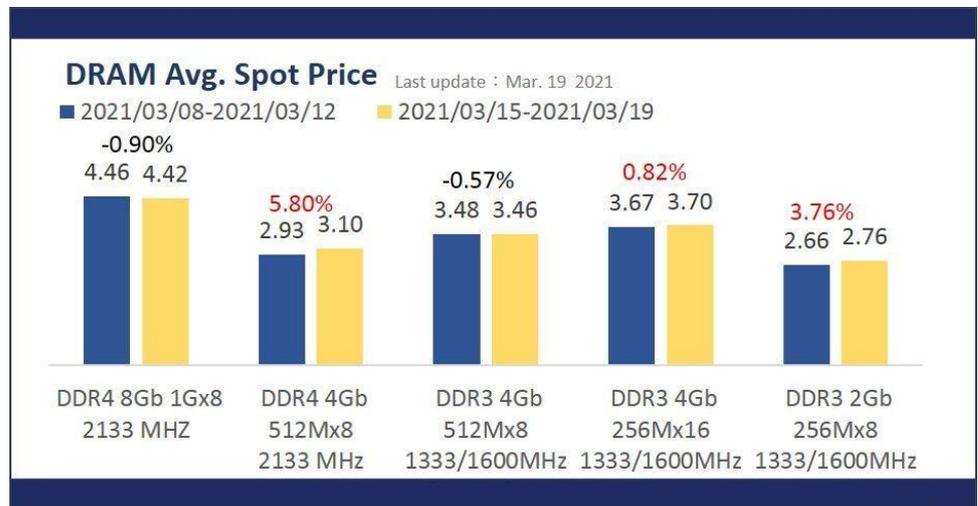
1 看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。半导体行业成本费用利润率、EBITDA/营业收入 2018 出现回升，预计未来将继续保持复苏提升趋势。固资累计折

旧较为稳定,成本占比上下半年呈锯齿状波动,因此可预计 2020H2 固资折旧会有所下降。固定资产周转率总体呈现上升,固资管理能力较强。封测板块将在 2020H2 迎来拐点,业绩开始回升。制造板块企业在 2018 年遭遇寒冬后,2019 年景气度回暖,下游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复。重点推荐:中芯国际/长电科技/闻泰科技/赛微电子/环旭电子/三安光电

2 制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注 5G、AI 和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。建议关注:北方华创/华特气体(机械)/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份(有色)

3 下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT 和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。5G 应用今年或迎快速发展,我们预计今年 5G 智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的增长。此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;5G 时代,各物联网终端尚不能直接支持 5G,但大部分 IoT 设备支持 wifi,5GCPE 有望成为 5G 时代新的流量入口;此外,5G 带动 AI 的发展,AI 进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。重点推荐:兆易创新/圣邦股份/北京君正/卓胜微/苏试试验(军工)

图 14: 本周 DRAM 价格变化 单位: 美元



资料来源: DRAMexchange、天风证券研究所

图 15: 本周 NAND 价格变化 单位: 美元



资料来源：DRAMexchange、天风证券研究所

图 16：主要半导体公司涨跌幅

代码	名称	区间内涨幅 (%)					价格 (元)		
		1月内	2月内	1月内	3月内	年初至今	年内最高价	年内最低价	最新收盘价
600460.SH	士兰微	-9.15	-12.25	-15.33	22.80	-3.48	30.96	20.75	24.13
002049.SZ	紫光国芯	1.54	-8.27	-6.70	-9.98	-22.64	151.88	95.20	103.52
300223.SZ	北京君正	-4.56	-18.78	-18.57	-39.36	-38.46	94.43	54.68	56.30
300672.SZ	国科微	4.64	-2.48	3.02	2.05	3.47	48.80	37.40	45.31
300661.SZ	圣邦股份	-12.32	-16.93	-22.73	-24.88	-19.01	355.00	213.18	213.66
300613.SZ	富满微	-5.76	-0.62	4.25	0.64	26.98	178.44	116.51	153.04
300671.SZ	富满电子	-5.62	-4.86	-4.92	-21.95	-23.93	47.20	29.95	33.06
600584.SH	长电科技	-8.20	-16.31	-21.30	-11.18	-20.32	48.98	32.81	33.92
603501.SH	韦尔股份	-0.65	-6.36	-15.07	10.91	11.83	328.00	225.01	258.43
603986.SH	兆易创新	-2.15	-12.38	-13.23	-15.80	-13.92	229.50	147.03	170.00
300458.SZ	全志科技	-5.25	-11.79	-12.47	-29.47	-15.53	34.70	26.42	27.24
603160.SH	汇顶科技	-13.39	-18.91	-20.61	-27.90	-28.58	164.89	109.64	111.10
002185.SZ	华天科技	-7.17	-13.65	-16.78	-19.23	-17.33	16.30	11.12	11.26
300327.SZ	中颖电子	-3.97	-17.29	-15.50	4.85	13.47	47.55	32.02	36.97
002156.SZ	瑞富微电	-8.33	-19.02	-24.89	-21.82	-21.08	31.10	19.71	19.92
002180.SZ	纳思达	-5.00	-8.20	-0.69	-9.29	-3.25	30.62	24.48	25.86
603005.SH	晶方科技	-15.33	-19.05	-26.10	-14.29	-13.77	91.88	52.80	55.50
002371.SZ	北方华创	-9.03	-22.57	-28.36	-10.69	-21.43	237.98	138.99	142.00

资料来源：Wind、天风证券研究所

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com